

BR® 624

Епоху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

BR® 624 potting compound is a one-part, low density material formulated for use in insert or edge filling of honeycomb sandwich construction. It is a thermosetting, modified epoxy system, serviceable over a temperature range of -70 to 350°F (-57 to 177°C).

BR 624 potting compound is thixotropic and cure cycles may be varied over a broad range. Cure temperatures as low as 225°F (107°C) and as high as 350°F (177°C) have been used successfully. Multiple cure cycles at temperatures up to 350°F (177°C) will not impair its use as a structural material.

Suggested Applications:

Insert and edge filling of honeycomb structures

Главная Информация	
Характеристики	Низкая плотность Тиксотропный
Используется	Заполнение приложений Детали конструкции
Внешний вид	Темно-бордовый
Формы	Паста
Метод обработки	Полировка Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	0.650	g/cm ³

NOTE	
1.	Approximate

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

